

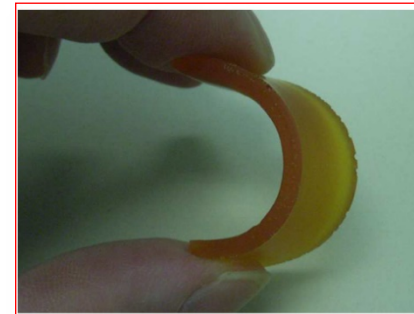
「2021 マイクロエレクトロニクスショー」に 当社の高機能接着材料を出展します



2021年10月27日（水）～29日（金）に東京ビックサイトで開催される「2021 マイクロエレクトロニクスショー」に当社の高機能接着材料を出展します。
半導体実装で培った接合技術をベースに、短時間硬化、低弾性高密着など、お客様のご要望に合わせた高機能な接着材料を開発し、ご提供しております。
ご来場の際は、是非お立ち寄りください。

- ・小間番号：南展示棟 3D-23
- ・出展ゾーン：eX-tech

【出展材料】



超短時間硬化接着剤	わずか3秒で完全硬化
低弾性高密着強度接着剤	シリコン並の柔らかさで、かつ、エポキシ並の高強度な材料
接着剤補強型Sn-Biはんだペースト	180℃以下接合可能で、SACはんだと同等以上の特性
融点変化型はんだペースト	200℃以下接合可能で接合後270℃まで材料全体が再溶融レス